



Firma MODECOM – producent sprzętu IT odświeża jedną ze swoich popularnych obudów.

**Obudowa Oberon** w swej pierwotnej wersji miała premierę lutym. Od tego czasu producent uważnie wsluchiwał się w komentarze użytkowników i recenzentów, czego efektem jest wprowadzenie zmodyfikowanych wersji Oberona.

W nowych wersjach bez zmian pozostają poniższe cechy, dzięki którym Oberon zaskarbił sobie popularność wśród użytkowników:

- Stonowana i nienachalna stylistyka

- Wykonanie i spasowanie elementów
- Panel boczny w formie okna
- Filtr przeciw kurzowi na górze obudowy
- Filtr przeciw kurzowi dla zasilacza
- Beznarzędziowy system montażu dysków
- Możliwość instalacji kart graficznych o długości nawet 395mm
- Odporne na odciski palców tworzywo
- Oddzielona komora dla zasilacza

Odświeżona wersja obudowy od poprzednika różni się przede wszystkim dodaniem cichego wentylatora 120 mm na froncie obudowy, który znakomicie wpływa na utrzymanie niskich temperatur wewnątrz obudowy a także zabezpieczeniem filtrem przeciwkurzowym otworu wentylacyjnego w dolnej części panelu przedniego. Przy okazji powyższych zmian wprowadzona zostanie również zupełnie nowa wersja, wyposażona w panel boczny wykonany ze szkła hartowanego. Panel taki charakteryzuje się większą odpornością na zarysowania, dzięki czemu użytkownik będzie mógł się cieszyć jeszcze lepszym wglądem do wnętrza swojego komputera.

Obudowy Oberon, tak jak dotychczas, dostępne będą w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej.

## **Specyfikacja**

Rodzaj obudowy

Midi tower

Wymiary obudowy

455 x 205 x 475 mm (L x W x H)

Format płyty głównej

ATX/microATX/mITX

Złącza na panelu przednim/ górnym

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

Wejście na mikrofon: TAK

Wejście na słuchawki: TAK/HD AUDIO

Rozwiązania beznarzędziowe

TAK

### Miejsca montażowe

1 x zewnętrzne 5.25"  
2 x wewnętrzne HDD 3.5"  
3 x wewnętrzne SSD 2.5"

### Maksymalna liczba wentylatorów

5

### Miejsce zainstalowanych wentylatorów

przód: 1 x 120 mm  
tył: 1 x 120 mm

### Liczba kart rozszerzeń

7

### Miejsce montażu zasilacza

dół obudowy

### Tunel na zasilacz

TAK

### Wysokość chłodzenia procesora

163 mm

### Maksymalna długość karty graficznej

395 mm

## Informacje dodatkowe

możliwość montażu wodnego systemu chłodzenia

TAK

panel boczny z oknem

TAK

filtr pod zasilaczem

TAK

filtr na panelu górnym

TAK

filtr na panelu przednim

TAK

grubość stali

0.7 mm

waga netto

5.27 kg

Sugerowana cena detaliczna obudowy OBERON (panel boczny z pleksi): 149 zł

Sugerowana cena detaliczna obudowy OBERON (panel boczny z hartowanego szkła): 189 złFirma MODECOM



*MODECOM, producent tabletów, smartfonów, nawigacji, akcesoriów komputerowych i gamingowych, to jedna z najszybciej rozwijających się firm z branży nowych technologii. Firma MODECOM powstała w roku 1999 dzięki pasji i chęci dostarczenia klientom wysokiej jakości innowacyjnych produktów w atrakcyjnych cenach. MODECOM został doceniony nie tylko przez rynek krajowy, ale także przez rynek zagraniczny m.in. podczas DISTREE EMEA 2015 w Monte Carlo, gdzie przyznano nagrodę Distree Diamond Award (w kategorii tablety) oraz Best Product Innovation dla FreePC – kieszonkowych rozmiarów komputera osobistego. MODECOM od wielu lat skutecznie wdraża strategię marketingu sportowego, m.in. poprzez współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, w ramach której cieszył się tytułem Oficjalnego Partnera Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej. Firma współpracowała również z Ekstraklasą, kiedy to na mocy podpisanej umowy posługiwała się tytułem Oficjalnego Partnera Ekstraklasy i jest pierwszą w Polsce firmą z branży IT, która równocześnie została partnerem Ekstraklasy, Kadry Narodowej i klubu piłkarskiego. MODECOM został sponsorem Poznań Game Arena na lata 2016 – 2017, umacniając swoją obecność w grupie graczy. Czasowo zbiegło się to z premierą doskonale przyjętych na rodzimym rynku akcesoriów gamingowych, które szturmem wdarły się również na rynki zagraniczne.*

[www.modecom.com](http://www.modecom.com)

## **MODECOM**

([press box](#))